



HP601は、小型表面実装タイプのフォトダイオードです。小型で省スペースの実装に適しています。

The H601 is a photo diode with a small and surface mount package. HP601 is a compact size and easy to mount on small space.

▶ 特長 FEATURES

- 鉛フリー半田リフロー実装対応
Lead-free, reflow-soldering is available
- 小型表面実装パッケージ
Small and surface mount package
-2.8(L) × 1.4(W) × 0.9(H)mm

▶ 最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

| Item | Symbol | Rating | Unit |
|-----------------------|--------|----------|------|
| 逆電圧 Reverse voltage | V_R | 30 | V |
| 動作温度 Operating temp. | Topr. | -25~+80 | °C |
| 保存温度 Storage temp. | Tstg. | -30~+100 | °C |
| 半田付温度 Soldering temp. | Tsol. | 260 | °C |

▶ 用途 APPLICATIONS

光電スイッチ、機器内透過センサ
Optical switches, Transmission sensor

▶ 電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

| Item | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|
| 短絡電流 Short circuit current | I_{sc} | $E_v=1,000Lx$ *1 | — | 3.2 | — | μA |
| 暗電流 Dark current | I_d | $V_R=10V$ | — | — | 50 | nA |
| 端子間容量 Capacitance | C_t | $V_R=10V, f=1MHz$ | — | 5.8 | — | pF |
| 応答速度 Response speed | tr, ts | $V_R=10V, R_L=1K\Omega$ | — | 0.2 | — | μsec |
| 分光感度 Spectral sensitivity | λ | — | 400~1100 | | | nm |
| ピーク感度波長 Peak wavelength | λ_p | — | — | 900 | — | nm |
| 半値角 Half angle | $\Delta\theta$ | — | — | ±65 | — | deg |

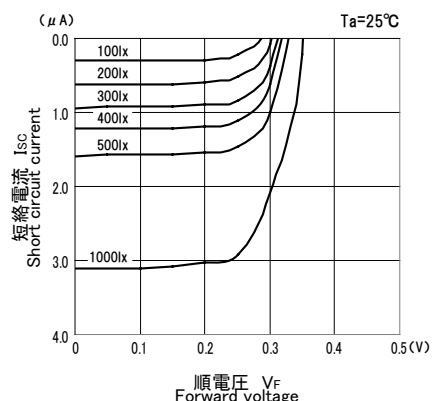
*1. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

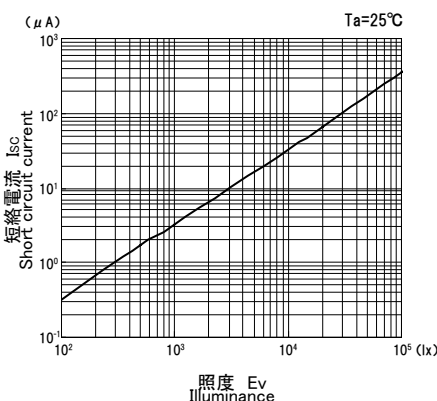
The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

フォトダイオード PHOTODIODES

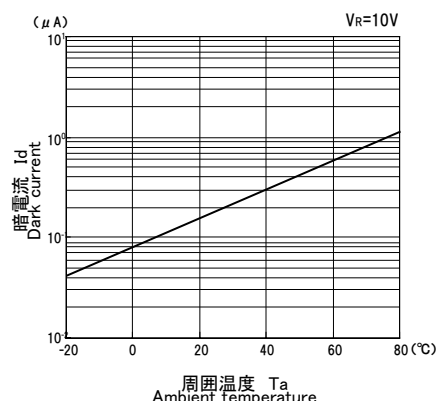
■ 短絡電流/順電圧特性 I_{sc}/V_F



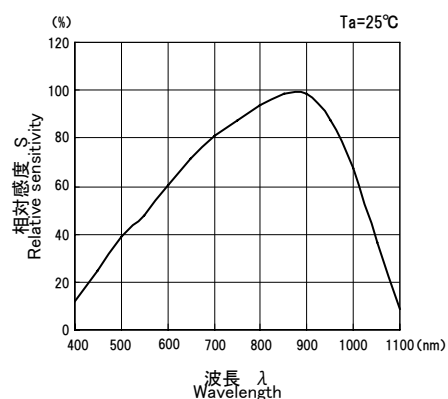
■ 短絡電流/照度特性 I_{sc}/E_v



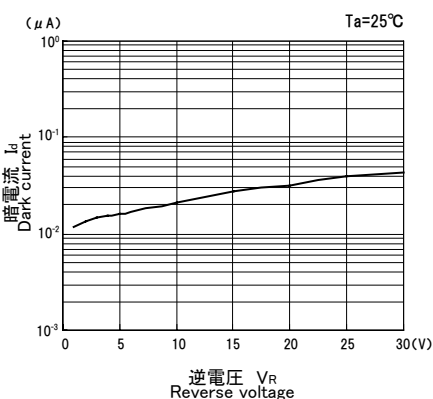
■ 暗電流/周囲温度特性 I_d/T_a



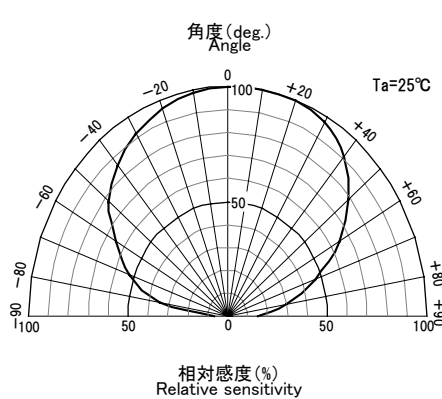
■ 分光感度特性



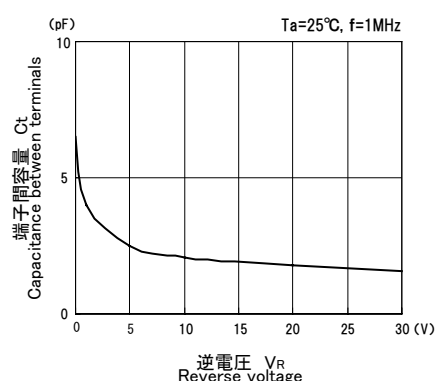
■ 暗電流/逆電圧特性 I_d/V_R



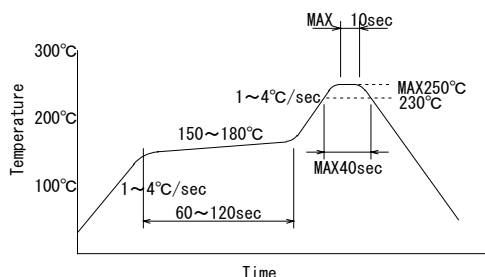
■ 指向特性



■ 端子間容量/逆電圧特性 C_t/V_R



■ リフロー条件 Reflow soldering



■ 手半田 Manual soldering

半田付けは260°C、3秒以内で行って下さい。
製品の変形、故障防止のため、半田付け時及び半田付け直後は製品に外力が加わらないようにご注意下さい。

Manual soldering Please solder by the limit once within 260°C 3 second.
To avoid the product is transformed and breakdown, it needs to take care that the power should not join to the product at soldering or immediately after soldering.

- 上記温度プロファイル内の条件であっても、基板の反り・曲がり等によりパッケージに応力が加わった場合、パッケージ内部の金線断線を誘発する恐れがありますので、ご使用になられるリフロー装置に於いて十分製造条件確認後、御使用下さい。
- リフロー時製品上にもものが重なった場合、パッケージ樹脂の変形を誘発する恐れがありますので、御注意お願い致します。
- リフロー半田を2回行う場合、1回目が終了して8時間以内に2回目の処理を行って下さい。リフロー半田は2回までとして下さい。

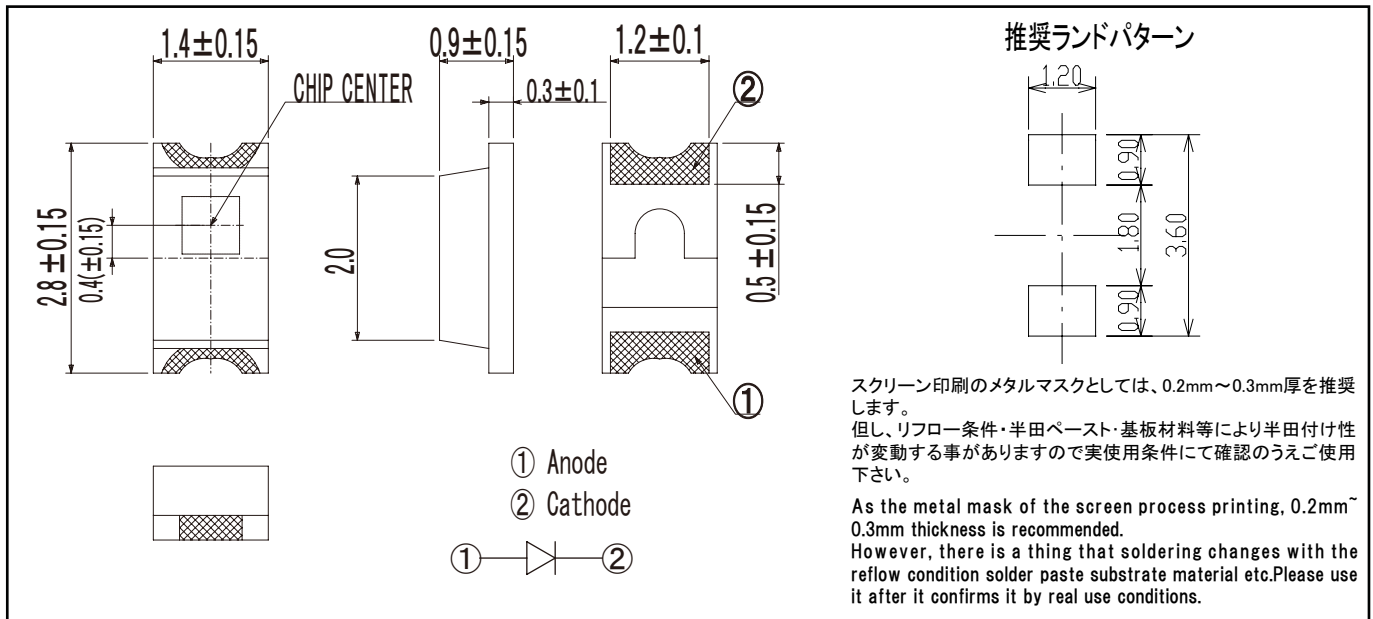
- Even it is within the temperature profile condition as below, the disconnection of Ag wire in the package might be caused by the stress join the package due to the PCB's curving and bending. Please take care about the condition of reflow machine when use.
- Please do not pile something on the product at reflow soldering because the transformation of the package resin may caused.
- When you do the reflow soldering twice, please process second reflow soldering within 8 hours after finish the first soldering. The reflow soldering is possible twice.

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.

フォトダイオード PHOTODIODES

▶ 外形寸法 DIMENSIONS(Unit : mm)



▶ 梱包仕様 Packing specification

本製品の輸送中及び保管中の吸湿をさけるため、防湿袋へ乾燥剤投入後シーラーにて密閉し包装を行います。
 プラスチックリール・防湿袋には表示シールを貼り付けます。
 最小梱包単位：1500個/リール

In order to avoid the moisture absorption under transportation of this product and storage, it sealed up in the dampproof bag with dry medicine. A display seal is stuck on a plastic reel and a dampproof bag.
 The minimum packing quantity : 1,500pcs/reel

▶ 保管上の注意 Cautions on storage

1. 本製品の吸湿をさけるため、開封前の保管環境としてはドライボックス保管が望ましいですが、ドライボックス保管が出来ない場合は下記条件を推奨します。
 温度：10～30℃ 湿度：60%RH以下
2. 本製品は防湿梱包をしておりますので、開封後は48時間以内でのご使用をお奨め致します。
 開封後保管される場合は、ドライボックス保管、または弊社納入時の防湿袋に乾燥剤を入れ、市販のシーラー等で再密閉し保管して下さい。
3. 防湿梱包状態で3ヶ月、もしくは防湿梱包開封後から24時間以上経過した製品は、ご使用前に下記条件にてベーキング処理を行って下さい。
 60℃：72時間～100時間(テーピング状態における推奨条件)
 80℃：24時間～48時間(バルク状態における推奨条件)

1. To avoid getting damp of this product, the dry box preservation is preferable before it opened. However, if it is impossible, the conditions stated below is recommended.
 Temperature : 10~30°C Humidity : 60%RH or less
2. Because this product packs the dampproof, it is recommended that used within 48 hours after opening.
 And when preserve again after opened, dry box preservation or using dampproof bag with dry medicine and seal up again with seal machine are recommended.
3. Three months passed with the dampproof packed or 48 hours or more passed after the dampproof packing is opened, please do the baking processing in the below condition before use.
 60°C × 72~100hrs (Reels)
 80°C × 24~48hrs (Balk)

問い合わせ先/A REFERENCE URL <http://www.kodenshi.co.jp>

- 東京営業/TOKYO SALES TEL 03-6455-0280 FAX 03-3461-1566
- 京都営業/KYOTO SALES TEL 0774-20-3559 FAX 0774-24-1031
- 海外/OVERSEAS TEL +81-(0) 774-24-1138 FAX +81-(0) 774-24-1031

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容の確認をお願い致します。

The contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product, would you please refer to the latest specifications.